



「山域留守人裝置 PCB 板開發及生產」委託規範書

一、購案名稱：

「山域留守人裝置PCB板開發及生產」採購案

二、目的/用途說明：

本案將對應今年迭代產品設計開發及生產規劃進行委託，將針對防水，對應後續新外殼規劃及燈號對應韌體開發進行 50 片電路板生產

三、履約期限與預算：

- 履約期限 **115 年 9 月 30 日**。

四、專案範圍：

本案主要以「山域留守人裝置 PCB 板開發及生產」

- 為全面化科技登山人留守服務，並改善登山者裝置使用者體驗，因應防水進行殼體修改等因素進行電路板修正開發及生產，本專案將進行電路板開發及改版，並須符合我方新裝置殼體尺寸及韌體燈號切換功能改良
- 本專案包含廠商修改測試及開發服務

五、技術支援程度：除了廠商提供硬體生產，需提供技術諮詢與支援，協助排除異常，直至電路板與新殼體安裝成功

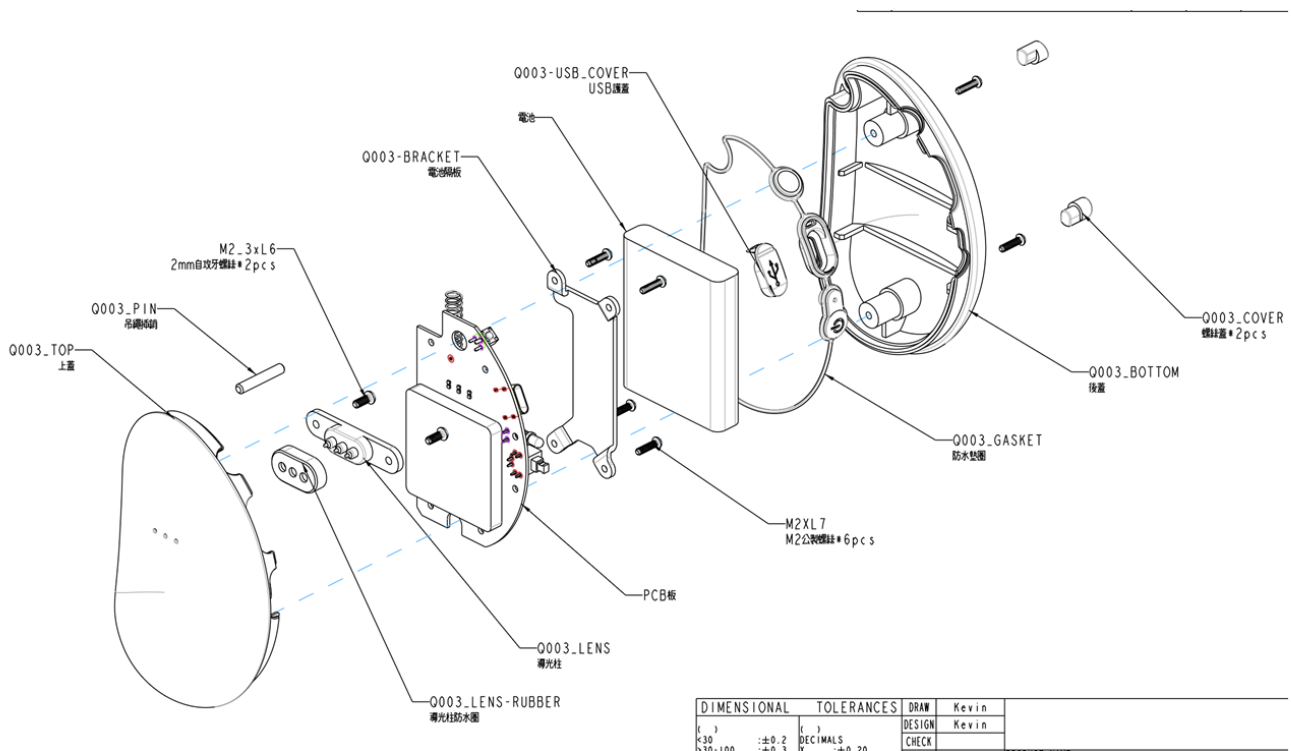


圖 新殼體設計

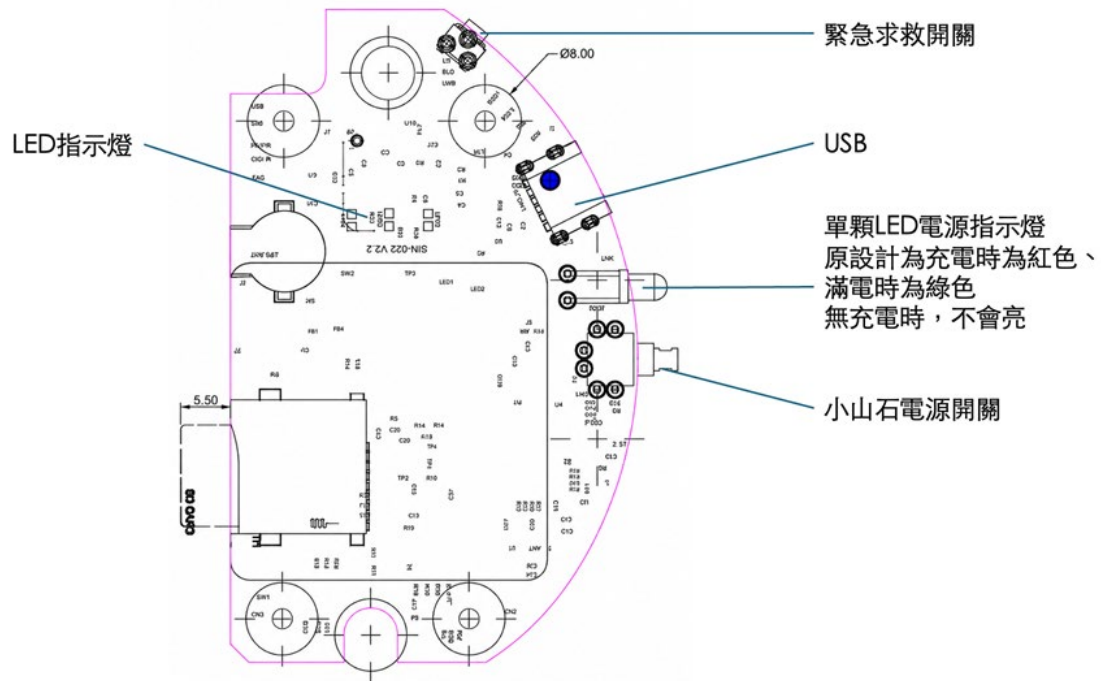


圖 電路板設計圖

六、此費用包含電路板生產50片及三層防水及電池

七、規格說明:

	規格及功能
系統規格	PCBA 加塗三防漆*50 片

八 驗收及付款標準：

日期	交付與驗收內容



	9/30/2026	<ul style="list-style-type: none">● 提供我方 50 片電路板及電池並防水層，規格需符合防水、燈號及使用者定義
--	-----------	--

本案付款分為一期，廠商完成所有交付項目，經本院驗收合格後，給付全額。